

事業戦略ビジョン

実施プロジェクト名：次世代高電力密度産業用電源（サーバ・テレコム・FA等）向けGaNパワーデバイスの開発

実施者名：東芝デバイス&ストレージ株式会社、代表名：代表取締役社長 佐藤 裕之

目次

1. 事業戦略・事業計画

- (1) 産業構造変化に対する認識
- (2) 市場のセグメント・ターゲット
- (3) 提供価値・ビジネスモデル
- (4) 経営資源・ポジショニング
- (5) 事業計画の全体像
- (6) 研究開発・設備投資・マーケティング計画
- (7) 資金計画

2. 研究開発計画

- (1) 研究開発目標
- (2) 研究開発内容
- (3) 実施スケジュール
- (4) 研究開発体制
- (5) 技術的優位性

3. イノベーション推進体制（経営のコミットメントを示すマネジメントシート）

- (1) 組織内の事業推進体制
- (2) マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与
- (3) マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ
- (4) マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保

4. その他

- (1) 想定されるリスク要因と対処方針

1. 事業戦略・事業計画

1. 事業戦略・事業計画／（1）産業構造変化に対する認識

社会構造等の変化によりパワーエレクトロニクス産業が急拡大すると予想

カーボンニュートラル（CN）を踏まえたマクロトレンド認識

（社会面）

- ・ 切迫する地球温暖化対策への意識の高まり
- ・ 「望ましい転換」でなく「取り組みが必須」が社会の合意へ、SDGsの策定

（経済面）

- ・ CN取り組みが、ビジネス（事業）へ
- ・ ESG経営への投資規模の拡大
- ・ 設備等の更新投資等はCN仕様が標準へ
- ・ 浸透に伴う規模の拡大で各種コストは低減

（政策面）

- ・ 設備切替やCN分野の研究開発等を後押しする政策の推進
- ・ 官公庁が模範・リード役を果たす展開

（技術面）

- ・ 再生可能エネルギー技術の多様化→送電ロス抑制技術
- ・ 省エネルギー、放熱抑制→インバータ技術の全面浸透、スイッチング電源の高度化

● 市場機会：

- ・ 各種規制に適合するための需要の拡大（例 EV化）、
- ・ CN化の全面展開による量的な需要の拡大

● 社会・顧客・国民等に与えるインパクト（パワー半導体）：

- ・ 電力変換ロスの低減と機器の軽量化、小型化に貢献
- ・ 駆動と制御の両面で機器の省エネ化実現に貢献

カーボンニュートラル社会における産業アーキテクチャ



CNに代表されるメガトレンドの課題解決に対しデバイス技術力で貢献



● 当該変化に対する経営ビジョン：

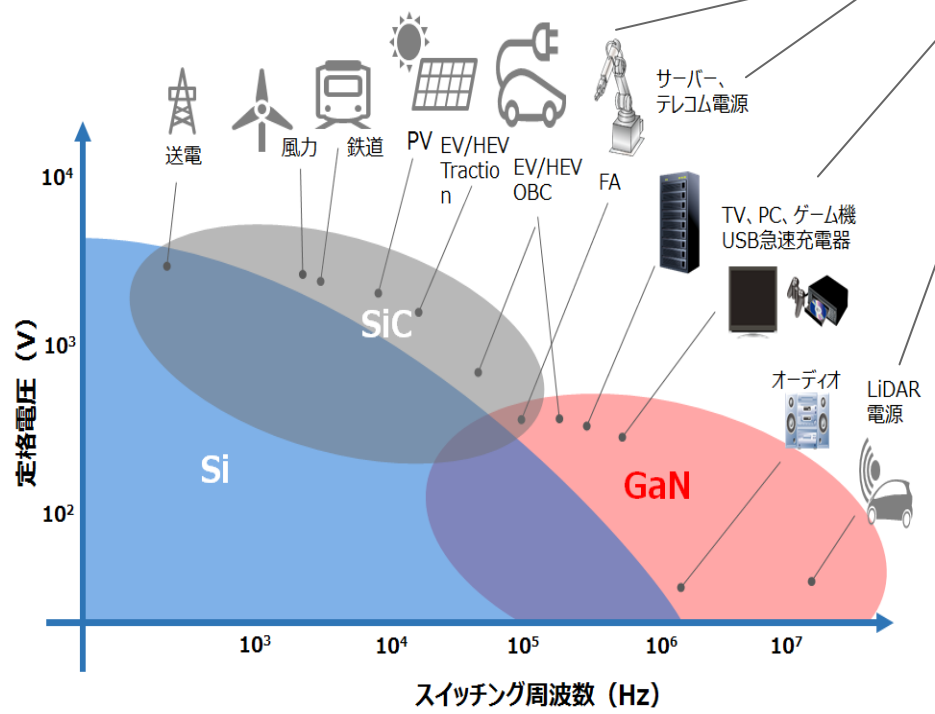
- ・ 社会インフラ/情報インフラの進化をリードするキーデバイス/キーコンポーネンツを提供し続ける
- ・ 環境負荷低減に貢献する製品の創出拡大と、カーボンニュートラルに向けた取り組みを加速

1. 事業戦略・事業計画／（2）市場のセグメント・ターゲット

パワーエレクトロニクス市場のうちGaNデバイス導入効果が大いスイッチング電源をターゲット

セグメント分析

GaN：高周波スイッチングにより、～kWクラスでの高効率・小型化が求められる機器への応用



ターゲットの概要

ターゲット市場（市場規模はGaNパワーデバイスの規模@2030年）

- 産業用電源：サーバー、テレコム、FAなど
- 民生電源：PC、TV、ゲーム機、USB急速充電器
- 車載電源：オンボードチャージャー、車載LiDAR電源

需要家	主なプレイヤー	市場規模	課題	顧客ニーズ
産業	産業用電源メーカー	517億円	<ul style="list-style-type: none">効率小型化信頼性	<ul style="list-style-type: none">部品点数削減低ノイズ高放熱パッケージ
民生	電源アダプター等 民生用電源メーカー	1308億円	<ul style="list-style-type: none">小型・薄型軽量化コスト	<ul style="list-style-type: none">低価格集積化
車載	車載電源メーカー	364億円	<ul style="list-style-type: none">効率信頼性小型・薄型	<ul style="list-style-type: none">IATF16949認証高放熱パッケージ

各カテゴリで共通のニーズ

- <10kWでの高効率・高電力密度化
- 機器の小型化

1. 事業戦略・事業計画／（3）提供価値・ビジネスモデル

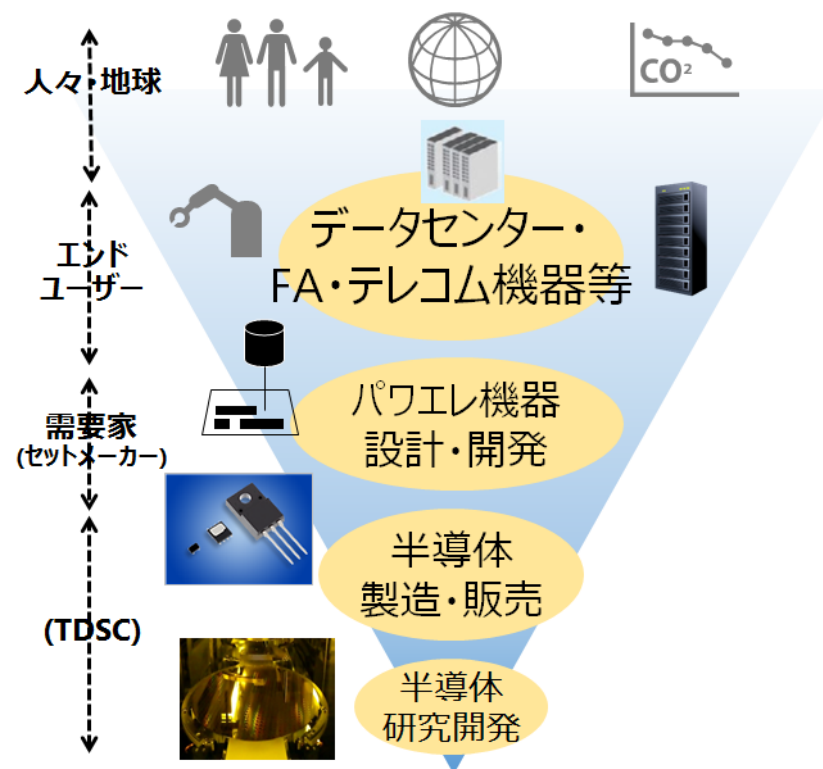
省エネ効果が高い電源用GaNデバイスを提供することで脱炭素社会に貢献

社会・顧客に対する提供価値

- デジタルインフラ機器やEV車のCO2排出量削減に貢献する、新構造ノーマリーオフ型GaN-FETデバイスを提供する
- GaN素子固有の問題を解決し、Si同等の使いやすさと艇コストな標準GaN素子の提供
- 高周波スイッチングが可能なGaN製品群により、電源の高電力密度化、小型化に貢献

ビジネスモデルの概要（製品、サービス、価値提供・収益化の方法）と研究開発計画の関係性

- パワエレで標準的な閾値電圧を持つノーマリーオフ型GaN-FETを提供し、業界標準に
- GaN-FETに加え、制御回路／周辺回路も含む製品ラインアップを提供。基板設計のしやすさを訴求
- 顧客設計のための諸データ、シミュレーション関連情報、評価ボードなどの技術サポート
- Siビジネスでの強固な顧客基盤によりグローバルな販売網・技術サポートを構築



1. 事業戦略・事業計画／（3）提供価値・ビジネスモデル（標準化の取組等）

パワーレ業界標準の特性実現によるデファクト標準化と、知財獲得による競争優位性確保

標準化を活用した事業化戦略（標準化戦略）の取組方針・考え方

ターゲット市場の特徴

- ＜産業用電源レイヤ＞
- ・電力変換効率を追求
- ・Siデバイス応用による性能飽和の顕在化と化合物半導体への期待大
- ＜GaN半導体デバイスレイヤ＞
- ・パワーレ標準となるデバイスの不在

自社の強み

- ・Siビジネスでの強固な顧客基盤
- ・グループ内にGaN材料・デバイス基礎研究の蓄積・実績がある（基本特許取得、学術発表）
- ・主要プロセス技術の蓄積



戦略

- ・知財獲得のクローズ戦略を優先
- ・Siデバイスで培われたパワーレ標準に準拠した、GaNデバイスの早期開発・市場投入と、顧客基盤を活かした有力顧客との連携によるデファクト標準化

国内外の動向・自社の取組状況

（国内外の標準化や規制の動向）

- ・アプリケーションレイヤ：電力変換効率規格
- ・半導体レイヤ：パッケージ外形や信頼性評価方法が業界団体で標準化されている

（これまでの自社による標準化、知財、規制対応等に関する取組）

- ・基本特許の取得
- ・製品仕様（パッケージ外形、性能）の公開
- ・スイッチング電源応用例（リファレンスモデル）の公開
- ・国内外のコンソーシアム参画による情報収集
- ・業界団体各種委員会への参加



本事業期間におけるオープン戦略（標準化等）またはクローズ戦略（知財等）の具体的な取組内容（※推進体制については、3.（1）組織内の事業推進体制に記載）

クローズ戦略（知財等）

- ・特許取得
- ・ノウハウは非開示

オープン戦略（標準化等）

- ・仕様等の公開
- ・顧客レイアと連携し、デファクト化を推進
- ・学会、展示会等の活用（デバイス、および電源応用）

1. 事業戦略・事業計画／（4）経営資源・ポジショニング

実績あるパワー半導体の強みを活かして、環境負荷低減に貢献

自社の強み、弱み（経営資源）

ターゲットに対する提供価値

- パワエレ業界標準閾値の高効率・MHz級スイッチング可能なGaNパワーデバイス、及びドライブ回路により、
 - 顧客システムの高効率化・電力損失低減
 - パワエレ機器の小型・薄型・軽量化と効率の両立



広くパワエレ機器の電力削減に貢献し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献

自社の強み

- パワー半導体技術の実績と人材
- エピタキシャル成長の保有技術
- グローバルで幅広い顧客基盤

自社の弱み及び対応

- GaNの製品化では後発も、パワエレの標準閾値電圧のノーマリーオフ型GaN-FETの製品化で巻き返しを図る
- グループ内にユーザ不在も、社外パートナーと連携していく

他社に対する比較優位性

	技術	顧客基盤	サプライチェーン	その他経営資源
自社	<p>【現在】</p> <ul style="list-style-type: none">ノーマリオンGaN+しきい値補正回路6インチ エピウェハを調達 <p>↓</p> <p>【将来】</p> <ul style="list-style-type: none">ノーマリオフ型新構造GaN-FETでSiデバイスと同等の使い易さを追求内製・8インチ化によるコスト低減、高品質化	<ul style="list-style-type: none">Siで構築した幅広い顧客基盤 <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none">Si顧客基盤を有効活用新規顧客の獲得	<ul style="list-style-type: none">エピウェハ外部調達 <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none">エピ内製化自社グループ装置メーカーとの共同開発	<ul style="list-style-type: none">(株) 東芝 研究開発センター研究者自社グループにエピ装置メーカ（NFT*） <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none">東芝グループ部門横断による競争優位な開発体制の構築と技術者育成
競合 I社	<ul style="list-style-type: none">ノーマリオフGaN（GIT型）ゲート誤オン耐性↓専用回路要	<ul style="list-style-type: none">Si、化合物の顧客基盤あり	<ul style="list-style-type: none">6インチ内製	<ul style="list-style-type: none">豊富なアプリケーションエンジニア
競合 T社	<ul style="list-style-type: none">ノーマリオンGaN+Nch LVMOS逆回復特性↓スルーレート制御不可	<ul style="list-style-type: none">GaN顧客のみ	<ul style="list-style-type: none">6インチ内製	<ul style="list-style-type: none">GaNパワーデバイス製品化のパイオニア

1. 事業戦略・事業計画／（5）事業計画の全体像

7年間の研究開発の後、150W/in³電源向けGaNデバイスを29年頃の事業化、
GaNデバイス事業全体の投資回収は32年頃を想定

投資計画

- ✓ 本事業終了後も約1年程度、研究開発を継続し、ノーマリオフ型GaNパワーデバイスについて29年度頃の事業化を目指す。
- ✓ 産業用電源市場での販売を図り、32年度頃に投資回収できる見込み。

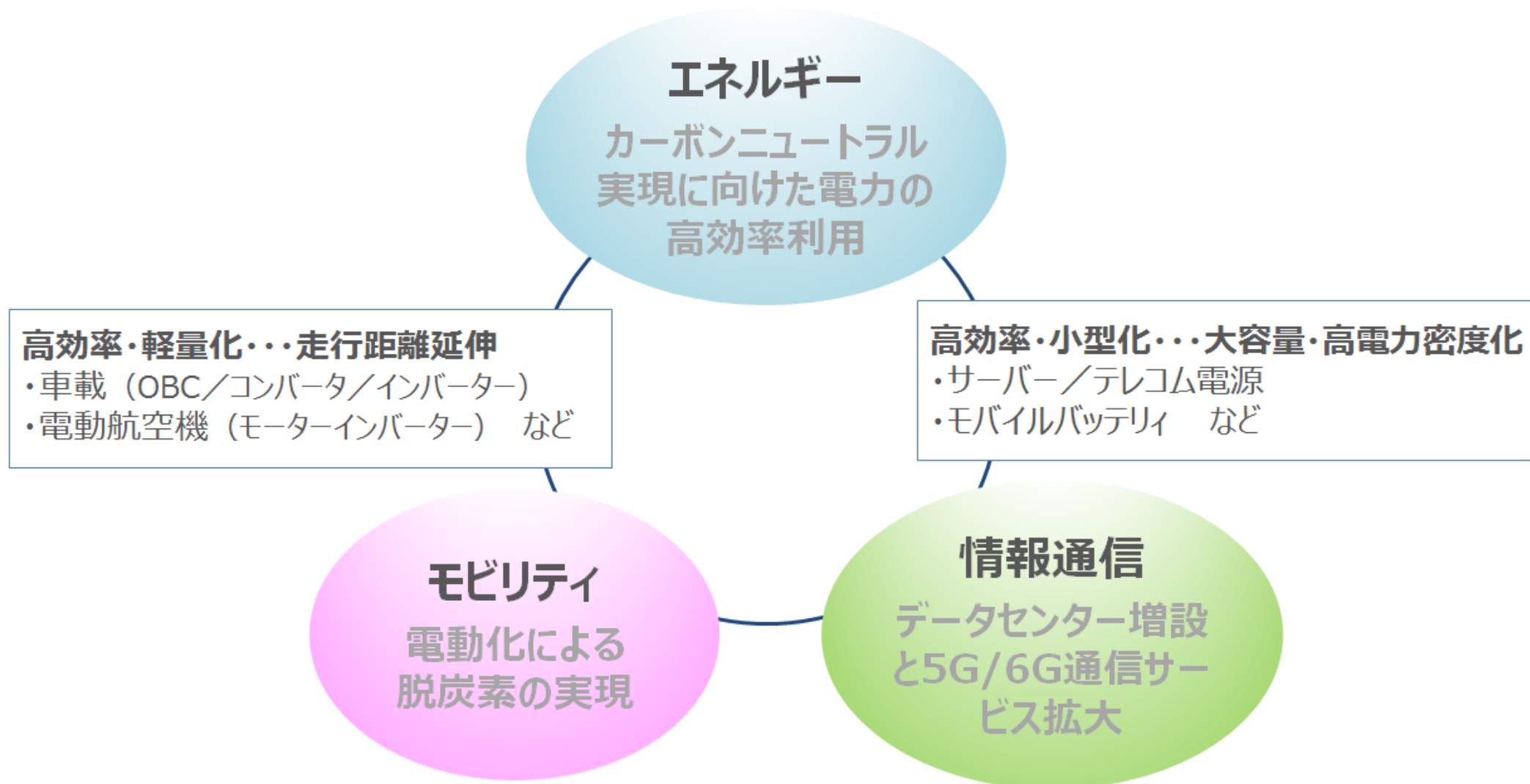
	研究開発							事業化	投資回収			
	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
売上高									約680億円			
研究開発費	約95億円（本事業の支援期間）							約8億円				
取組の段階	研究開発の開始		研究サンプル①		研究サンプル②	ドライブICサンプル	電流センシング研究サンプル					
CO ₂ 削減効果 （万t－CO ₂ ）	0	0	0	0	0	0	0	0	329	398	516	588

1. 事業戦略・事業計画／（6）研究開発・設備投資・マーケティング計画

研究開発段階から将来の社会実装（設備投資・マーケティング）を見据えた計画を推進

	研究開発・実証	設備投資	マーケティング
取組方針	<ul style="list-style-type: none">本プロジェクトで得られた知見は、速やかに知財化を検討する技術が確立しているSi搭載電源を基準として、GaNデバイスの有効性を検証する連携企業には、初期段階から参画頂き、シミュレーションも活用してGaNデバイスの有用性を検証、またニーズを把握しながら開発	<ul style="list-style-type: none">研究試作ラインを構築エピ開発・生産拠点、及び大口径化合物専用生産ラインを整備予定	<ul style="list-style-type: none">既存Si販売顧客、チャネルを活かした拡販推進製品リリースにあわせた顧客サポート体制やWebコンテンツを拡充顧客VoC入手により製品改善、試作へフィードバック
進捗状況	<ul style="list-style-type: none">GaNデバイスの有用性実証に向け、連携会社との協議を実施	<ul style="list-style-type: none">研究試作ライン構築に向け準備中エピ開発拠点を整備中	<ul style="list-style-type: none">GaNデバイスの電源応用に関して、顧客レイヤの検討促進のための諸活動を開始
国際競争上の優位性	<div>▼</div> <ul style="list-style-type: none">パワエレ標準の閾値と高周波スイッチングに適した特性を実現可能な独自技術を保有している開発初期からユーザ企業に参画頂き、ニーズに合致した製品を他社に先駆けて上市可能	<div>▼</div> <ul style="list-style-type: none">東芝デバイス&ストレージ（株）グループ内に半導体装置メーカーのニューフレアテクノロジー（株）を保有しており、垂直統合型のデバイス開発が可能GaNエピタキシャル工程を内製化し、品質及びコスト競争力向上を目指す	<div>▼</div> <ul style="list-style-type: none">国内パートナーと協業し、開発、製品化を加速

高周波スイッチングにより機器の高効率・小型・軽量化に貢献



ユーザー要求を満たすユーザーフレンドリーな製品による市場参入と拡大

1 高性能・高品質・低コストGaNパワーの創出

2 システム性能とコストを考慮した製品ラインナップの拡充

3 顧客技術サポートの充実

1. 事業戦略・事業計画／（7）資金計画

国の支援に加えて、201億円規模の自己負担を予定

単位：億円

	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度	2031 年度	2032 年度	2033 年度
事業全体の 資金需要	約223億円							本事業期間にて量産化開発を完了させた後、引き続き高効率GaNデバイス技術の確立に向け、自己負担により継続的な研究開発投資や、量産ライン構築等の設備投資を実施する予定				
うち研究開発投資	約95億円											
国費負担※ （補助）	約22億円											
自己負担	約201億円											

※2029年度以降のインセンティブを含む国費負担の総額

2. 研究開発計画

2. 研究開発計画／（1）-1 研究開発目標

「電源効率98%、電力密度150W/in³」を達成するために必要なGaN素子特性のKPI

研究開発項目	アウトプット目標		
1. ノーマリオフ型新構造GaN-FETの開発	効率98%（損失50%減）、電力密度150W/in ³ を満たす電源向けGaNパワー素子		
研究開発内容	KPI	KPI設定の考え方	
① デバイス構造設計	(a) V _{th} 、(b) 移動度、(c) 出力電荷量、(d) 耐圧の各項目について、KPI設定の考え方を満たすデバイス構造設計を決定する。	(a) スイッチング時のノイズによる誤作動防止に十分な値であること cf. Si系パワーMOSFETのV _{th} = 3V (b) 高速スイッチング可能、且つ、導通損失低減に寄与 (c) SW損失低減に寄与 (d) 定格電圧650Vに対して余裕がある耐圧	
② 要素プロセス開発 ・MOS構造形成	(a) V _{th} 、(b) 移動度は①の設計を実現するMOS形成プロセスであること。 (c) ΔV _{th} （BTI試験）、(d) TZDBは、パワー素子の一般的な値を実現。	(a)(b) V _{th} やμはデバイス構造、チャンネル層やゲートの物理パラメータなどに依存 (c)(d) 構造形成部のダメージや、ゲート/チャンネル部のラフネス等は、素子の電氣的安定性やゲート絶縁膜の破壊電圧に影響	
③ プロセスインテグレーション	(a) チャンネル抵抗・出力容量積は、KPI設定の考え方を満足すること。 (b) 研究開発内容①②記載のKPIを実現し、且つ(a)を同時に満足するプロセスフローを確立する	①導通損失、スイッチング損失、デッドタイム時間等のユーザリクアイメントを満たす指標として設定 ②研究開発内容①②に記載の通り ③実用化に向けて、特性と信頼性を単一素子レベルで満たすことが必要	

2. 研究開発計画／（1）-2 研究開発目標

コストが「Siと同等」を達成するための鍵となる、GaNEピタキシャルプロセスのKPI

研究開発項目	アウトプット目標	
2.高品質・低コストエピタキシャル成長技術の基礎開発	コストが「Siと同等」を満たすSi基板上へのGaNEピタキシャルプロセス	
研究開発内容	KPI	KPI設定の考え方
① 低欠陥化	(a) 表面欠陥密度、(b) 転位密度は、KPI設定の考え方に基づき、現状のファクター以下を実現する	歩留、および信頼性向上を実現するために必要な指標として設定 (a) 耐圧やリーク歩留向上に寄与 (b) 閾値電圧やオン抵抗変動抑制に寄与
② 大口径化	(a) 反り、(b) クラックの長さは、デバイス製造工程に不具合が生じない範囲に抑制する。	(a) デバイスプロセス不良の抑制に寄与 (b) デバイスプロセス時のウェハの割れ抑制、ウェハの有効面積拡大による低コスト化に寄与 ただし、研究開発項目 1 の指標を満たす膜厚であること。
③ スループット向上	(a) 結晶成長プロセス時間は、現状に対しファクターで削減する	(a) 成長速度の高速化やプロセスシーケンスを改善し、結晶成長時間を短縮

2. 研究開発計画／（1）-3 研究開発目標

電源の電力密度 150W/in³ に向けたGaNパワーデバイス開発、及び全体検証のKPI

研究開発項目

3. 周辺回路技術

研究開発内容

① 電流センサー回路

② ドライブ回路

アウトプット目標

電源の電力密度150W/in³を満たす電源向けGaNパワーデバイス
→ 高周波スイッチング電源の実用化に必要なGaNパワー素子周辺回路を開発

KPI

電流センサー帯域は、現状に対し
て5倍以上を実現

伝播遅延は、KPI設定の考え方
に基づく伝番遅延を実現

KPI設定の考え方

高周波スイッチング電源のピーク電流制御のための電流検出に
十分な電流センサーを目指す。

高周波スイッチング電源に対応する制御性と保護性能確保に十分
なターンオン及びターンオフ伝播遅延を目指す。

4. PoCの試作と評価

研究開発内容

① SiからGaNへの置換え
の効果確認・課題抽出
(既存GaN評価ボード)

② 高周波スイッチング化の
効果確認・課題抽出

③ 高電力密度化の効果
確認・課題抽出

アウトプット目標

電力密度150W/in³、コストSi同等満たす電源実現に向けた試作・評価
→ 高周波スイッチング電源のPoCを構想・企画すると共にデバイス側にFB。最終的に試作・評価を実施

KPI

スイッチング周波数：現状と同等レ
ベル

スイッチング周波数：数倍

スイッチング周波数：桁倍

KPI設定の考え方

SiとGaNの素子パラメータの違いによる電源回路特性への影
響を評価頂く（理論計算・シミュレーション・実測など）

スイッチング周波数を変えた場合の、受動部品も含めた電力密
度・損失・コストへの影響を検討するための基礎評価

高周波スイッチング電源の電力密度・損失・コストを検証するた
めのPoCを構想・企画・試作・評価

2. 研究開発計画／（2）-1 研究開発内容（全体像）

ノーマリオフ型新構造GaN-FETの開発KPIの目標達成に必要な解決方法

	KPI	現状	達成レベル	解決方法	実現可能性 (成功確率)
1 デバイス構造設計	(a) Vth (b) 移動度 (c) 出力電荷量 (d) 耐圧	要素技術開発 (TRL4)	サンプル 試作検証 (TRL7)	(a)(b) 要素プロセス技術の量産ラインへの適用 (c)(d)・MOS型デバイスにけるFP設計技術開発 ・高電界下のゲート-ドレイン間における 空乏層制御による電界分布制御技術開発	コンセプト確認済、 デバイスとしての 検証を進める (60%)
2 要素プロセス開発 ・MOS構造形成	(a) Vth (b) 移動度 (c) ΔVth (BTI試験) (d) TZDB	要素技術開発 (TRL4)	サンプルを試 作して検証 (TRL7)	(a) MOS構造最適化によるしきい値制御技術開発 (b) チャネル領域の高品質化技術開発 (c)(d) ゲート絶縁膜の高品質化技術開発	コンセプト確認済、 要素技術の深耕 とデバイスへの展 開を図る (85%)
3 プロセスインテグレーション	(a)チャネル・出力容量 (b) 研究開発校項目 ①②記載のKPI (c) (a)(b)を同時に 満たすこと	要素技術開発 (TRL4)	サンプルを試 作して検証 (TRL7)	(a)(b)(c) ・要素プロセス技術の量産ラインへの適用 ・MOSゲートプロセスとFP構造プロセスのプロセスインテグレーション技術開発	コンセプト確認済、 デバイスとしての 検証を進める (60%)

2. 研究開発計画／（2）-2 研究開発内容（全体像）

GaNエピタキシャルプロセスKPIの目標達成に必要な解決方法

	KPI	現状	達成レベル	解決方法	実現可能性 (成功確率)
1 低欠陥化	(a) 表面欠陥密度 (b) 転位密度	技術コンセプトを確認 (TRL3)	パイロットラインでの検証 (TRL8)	(a) 表面欠陥発生メカニズム解明と抑制技術確立 (b) 転位生成・消滅メカニズムの解明 反りとの両立が可能な転位制御層の開発	コンセプト確認済み、大口径化との両立が課題 (60%)
2 大口径化	(a) 反り (b) クラック	要素技術開発 (TRL4)	パイロットラインでの検証 (TRL8)	(a) 応力バランスを適正化する層構造設計とエピタキシャル成長技術の開発 反り・欠陥を抑制する結晶成長基板の検討 (b) 高品質界面形成技術開発	構造設計と実現に必要な要素技術を開発中 (80%)
3 スループット向上	(a) 結晶成長プロセス時間削減	要素技術開発 (TRL3)	パイロットラインでの検証 (TRL8)	(a) 高品質エピタキシャル結晶の高速成長技術開発	要素技術を開発中、大口径化との両立が課題 (70%)

2. 研究開発計画／（2）-3 研究開発内容（全体像）

各KPIの目標達成に必要な解決方法を提案

3. 周辺回路技術

	KPI	現状	達成レベル	解決方法	
1 電流センサー回路	電流センサー帯域	要素技術開発 (TRL3)	研究サンプル試作検証 (TRL6)	<ul style="list-style-type: none">シャントMOS電流センサ<ul style="list-style-type: none">ばらつき補正技術により検出精度を確保しつつ広帯域化を実現	センサ広帯域化とノイズ抑制の両立が課題。 (80%)
2 ドライブ回路	伝播遅延	要素技術開発 (TRL2)	サンプル試作検証 (TRL7)	<ul style="list-style-type: none">高駆動力ゲートドライバ<ul style="list-style-type: none">駆動力調整回路の伝搬遅延時間を低減	要素技術をシミュレーション検証中。実機検証が課題。 (80%)

4. PoCの試作と評価

1 SiからGaNへの置換えの効果確認・課題抽出 (既存GaN評価ボード)	<p>「次世代高電力密度産業用電源（サーバ・テレコム・FA等）向けGaNパワーデバイスの開発」という開発テーマにおいて、本研究項目は、</p> <ul style="list-style-type: none">電源応用向けのGaNデバイスの仕様策定へのFB研究開発したGaNデバイスによりSiでは実現し得ない電源が実現できることの検証を主目的とするもの。 <p>電源開発そのものが主目的ではなく、オブザーバー企業との連携により実施。</p>
2 高周波スイッチング化の効果確認・課題抽出	
3 高電力密度化の効果確認・課題抽出	

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（これまでの取組）

ノーマリオフ型新構造GaN-FETの研究開発の進捗度

研究開発内容	直近のマイルストーン	これまでの（前回からの）開発進捗	進捗度
1 デバイス構造設計	出力容量の最終目標値を達成するデバイス構造の設計	Vth決定構造因子として想定される各パラメータの影響度に関するデータ取得・整理を実施中。今後のデバイス設計・デバイスシミュレーション(TCAD)モデル構築の参照データとして活用していく予定。	○ 計画通り進捗
2 要素プロセス開発	・移動度： オン抵抗の目標値を満たす移動度の達成 ・TZDB： 最終仕様の達成	移動度改善に向け、移動度に影響すると考えられる各プロセス条件、及びプロセスシーケンスを検討し、目標値に近い移動度が得られた。更な最適化を実施中。	◎ 移動度改善にメド
3 プロセスインテグレーション	出力容量のSG1目標値を達成する素子の試作ライン構築	PJ発進当初のプロセスフロー、デバイスデザインを適用した試作と評価を実施し、現状を把握した。出力容量低減に向け設計環境を整備し、デザインリファインを進める。 試作ラインは23年度発注に向けて下準備中も、装置納期遅延の顕著化により一部装置が23年度中に納品できない懸念が浮上。納期前倒し、計画見直し等を検討中。	△ 装置納期懸念

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（これまでの取組）

GaNエピタキシャルプロセスの研究開発の進捗度

研究開発内容	直近のマイルストーン	これまでの（前回からの）開発進捗	進捗度
1 低欠陥化	X線解析半値幅がSG1 目標値を満たすバッファ ー形成	成膜条件によるバッファの詳細物理解析を実施。 バッファ層品質を決めるいくつかの因子を抽出した。 得た知見を基に、プロセス条件を検討中。	○ 計画通り進捗中
2 大口径化	SG1 目標値を満たす反 り	大口径エピ開発のための装置改造の手配完了、2月改造完了予定。	○ 計画通り進捗中
3 スループット 向上	耐圧維持してプロセス時 間10%削減	スループット向上が見込める多層膜構造の基礎検討を実施した。耐圧 評価にて、想定内のリーク電流の増加が観測された。今後、膜パラメータ の調整等のリーク電流低減施策を検討する。また、並行してピットの断面 解析や定量評価を進める。	○ 計画通り進捗中

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（これまでの取組）

周辺回路技術・PoCの試作と評価の研究開発の進捗度

3.周辺回路技術の研究開発の進捗度

研究開発内容	直近のマイルストーン	これまでの（前回からの）開発進捗	進捗度
1 電流センサー回路	(研究開始前)	(研究開始前)	(研究開始前)
2 ドライブ回路	SG1目標値を満たす伝搬遅延	回路案に対してシミュレーションを実施し、SG1目標値の伝番遅延び達成目処が立った。	◎ 前倒して進捗

4.PoCの試作と評価の研究開発の進捗度

1 SiからGaNへの置換えの効果確認・課題抽出	100kHzレベル	オブザーバー社にて評価いただくGaN搭載電源ボードの試作を実施した。また、オブザーバー社と数度の打ち合わせを実施した。	○ 計画通り進捗
-----------------------------	-----------	---	----------

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（今後の取組）

ノーマリオフ型新構造GaN-FETの研究開発における技術課題と解決の見通し

研究開発内容	直近のマイルストーン	残された技術課題	解決の見通し
1 デバイス構造設計	出力容量の最終目標値を達成するデバイス構造の設計	<ul style="list-style-type: none">・MOS構造部のデバイスモデル作成・作成したモデルを用いてシミュレーションを実施し、デバイスシュリンク方針を策定する	<ul style="list-style-type: none">・社内のシミュレーション部隊とも連携していくことでMOS構造部のデバイスモデル作成を推進する。・作成したモデルを用いてシミュレーションを実施したうえで、以後の設計方針の策定を行い見通しを付ける。
2 要素プロセス開発	<ul style="list-style-type: none">・移動度：オン抵抗の目標値を満たす移動度の達成・TZDB：最終仕様の達成	<ul style="list-style-type: none">・移動度への影響が認められたプロセスの処理条件の最適化による移動度目標の達成・TZDB目標の達成に向けた取り組みに着手	<ul style="list-style-type: none">・移動度については目標値に近づいており、処理条件の最適化により達成に目途。・TZDB目標達成に向け、課題抽出に取り組み、以後の研究方針の策定を実施し見通しを付ける。
3 プロセスインテグレーション	出力容量のSG1目標値を達成する素子の試作ライン構築	<ul style="list-style-type: none">・SG1目標値の達成に向けた設計環境の整備・試作ライン構築にむけた装置納期確保。	<ul style="list-style-type: none">・設計環境整備については一定の既存技術を有しており、これをベースに本デバイス向けの設計環境を整備していく方針。・装置納期前倒し、計画見直し等を検討中。外的要因強く見通しは不明。

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（今後の取組）

GaNエピタキシャルプロセスの研究開発における技術課題と解決の見通し

研究開発内容	直近のマイルストーン	残された技術課題	解決の見通し
1 低欠陥化	X線解析半値幅がSG1 目標値を満たすAlNバッ ファー形成	・品質を決める因子に関わるプロセス条件の 最適化	物理解析による欠陥の初期核形成と、各プロセス条 件／プロセスシーケンスとの相関を検討し、最適プロ セスの見通しを付ける。
2 大口径化	SG1 目標値を満たす反 り	・大口径化のための装置改造の遂行 ・エピの大口径化時の反り実力把握と改善	・装置改造後の実力把握にて問題点抽出を行い、 目標達成についての具体的な行動指針の策定を行 う。
3 スループット 向上	耐圧維持してプロセス時 間10%削減	・耐圧改善に向けた膜パラメーターの最適化、 及びピットの定量評価による耐圧影響評価	・耐圧改善については、これまでのエピ開発の経験を 踏まえ、膜パラメーターの調整を行う。 ・ピットについては発生起因の解析を進めるとともに、 定量評価の結果をもって耐圧への影響度を確認した うえで優先度含めた具体的な行動指針を定める。

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（今後の取組）

周辺回路技術・PoCの試作と評価の研究開発における技術課題と解決の見通し

3. 周辺回路技術の研究開発の進捗度

研究開発内容	直近のマイルストーン	残された技術課題	解決の見通し
1 電流センサー回路	(研究開始前)	(研究開始前)	(研究開始前)
2 ドライブ回路	SG1目標値を満たす伝搬遅延	(FY23は計画中止)	

4. PoCの試作と評価の研究開発の進捗度

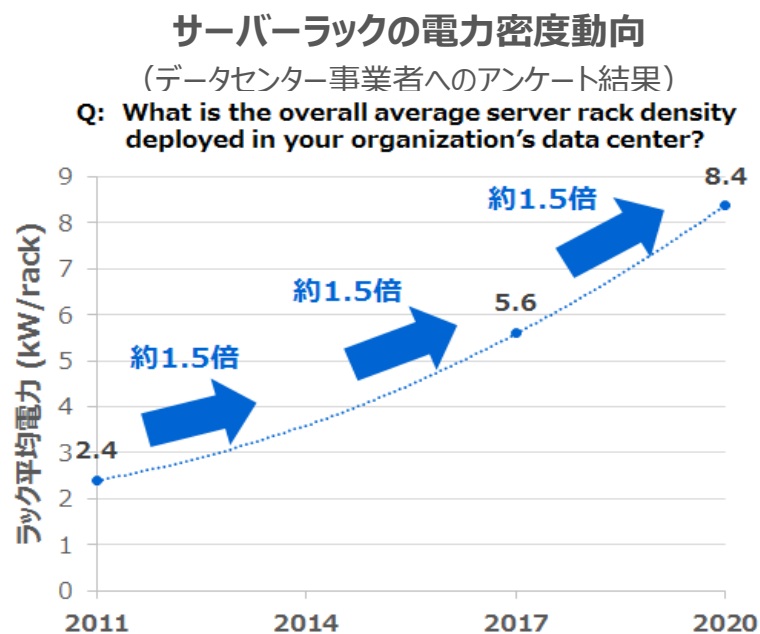
研究開発内容	直近のマイルストーン	残された技術課題	解決の見通し
1 SiからGaNへの置換えの効果確認・課題抽出	100kHzレベルの動作	電源回路レベルでの効果確認	PCB基板の寄生成分を最小化することによりで電源回路で実証を行う。

研究の最終目標設定の考え方

✓ サーバラックは、高電力密度化の動向

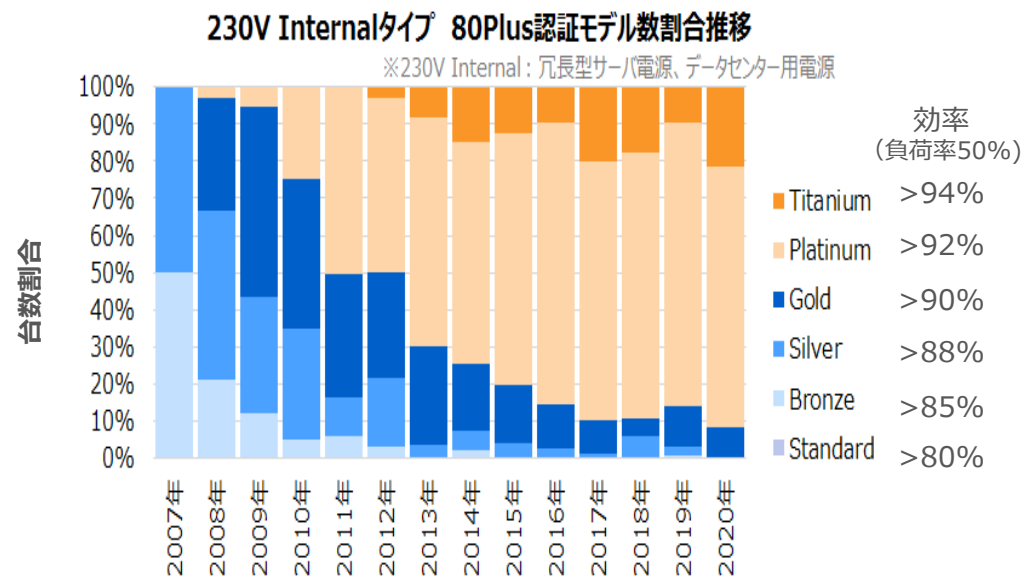
✓ 電源の高効率が進んでいるが、Si搭載電源は電力密度との両立に課題

⇒ 高効率・高電力密度化（小型・薄型・軽量）両立がGaNの電源応用の訴求点



(Source: Uptime Institute Global Data Center Survey 2020)

サーバラックの電力密度は「**3年で1.5倍**」増大

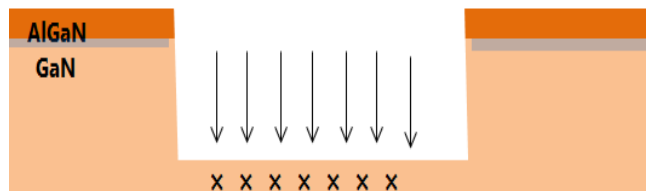


(Source : <https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>)

Si搭載電源でPlatinum電源は80%シェア@8年、Titanium電源は20%シェア@6年で拡大 ➡ 近年、**高効率化が加速傾向**

参考資料：ノーマリオフ型新構造GaN-FETの課題

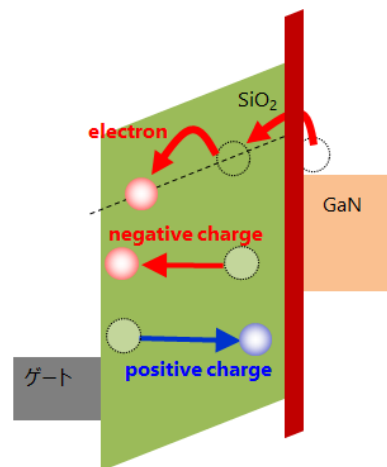
リセスエッチングプロセス技術



リセス形状制御と低ダメージ化の両立

→ 閾値電圧と高チャネル移動度を実現するエッチングプロセスの確立

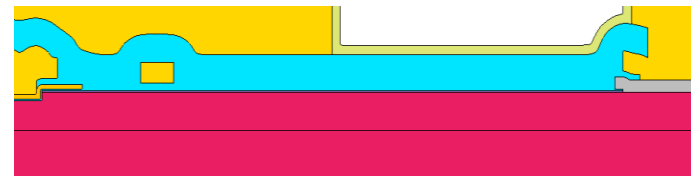
ゲート絶縁膜形成技術



積層ゲート絶縁膜形成

→ 高チャネル移動度とSiデバイス同等のゲート駆動電圧の確保

MOS型デバイスにおける高耐圧化

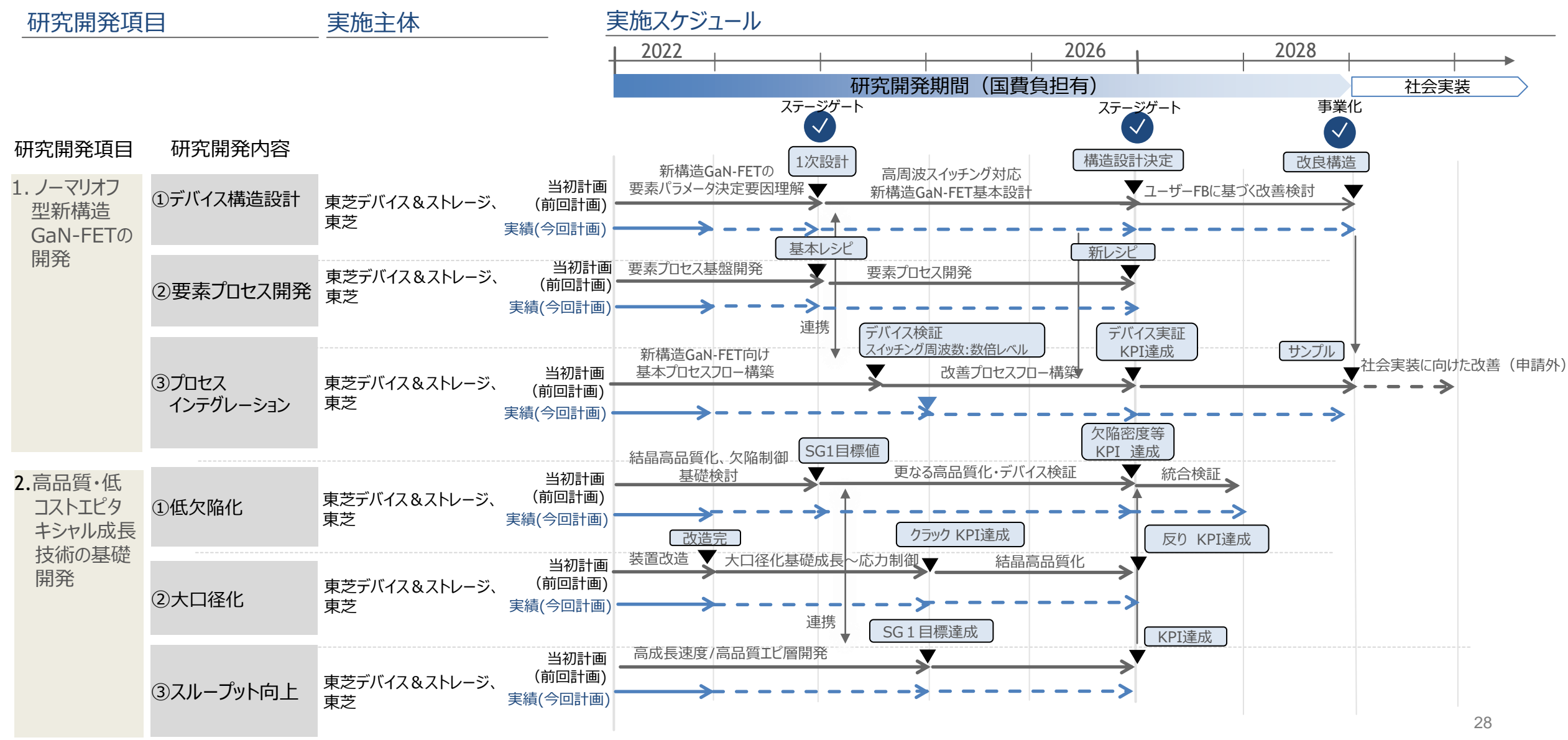


電界分布制御

→ ノーマリオンデバイス高信頼性技術の展開

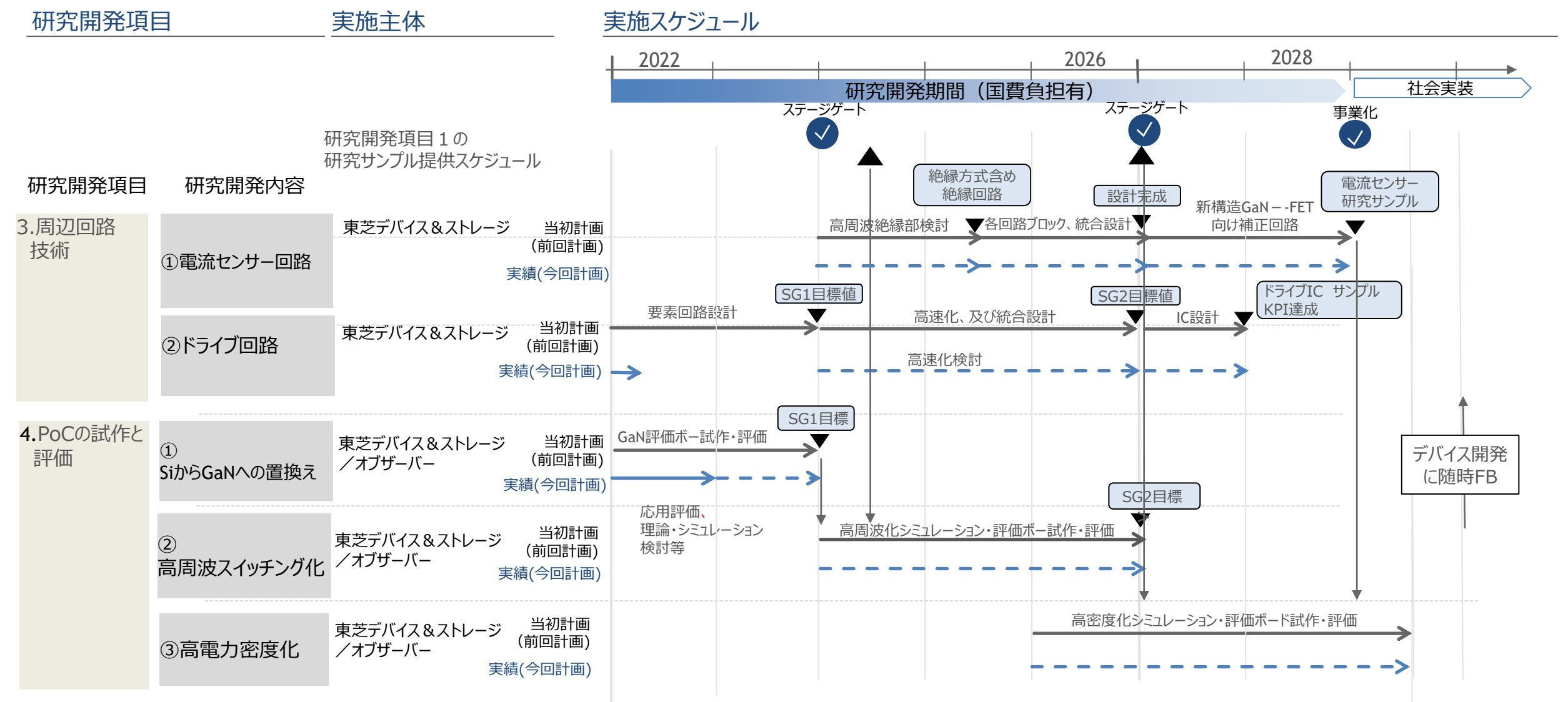
2. 研究開発計画／（3）実施スケジュール

複数の研究開発を効率的に連携させるためのスケジュールを計画



2. 研究開発計画／（3）実施スケジュール

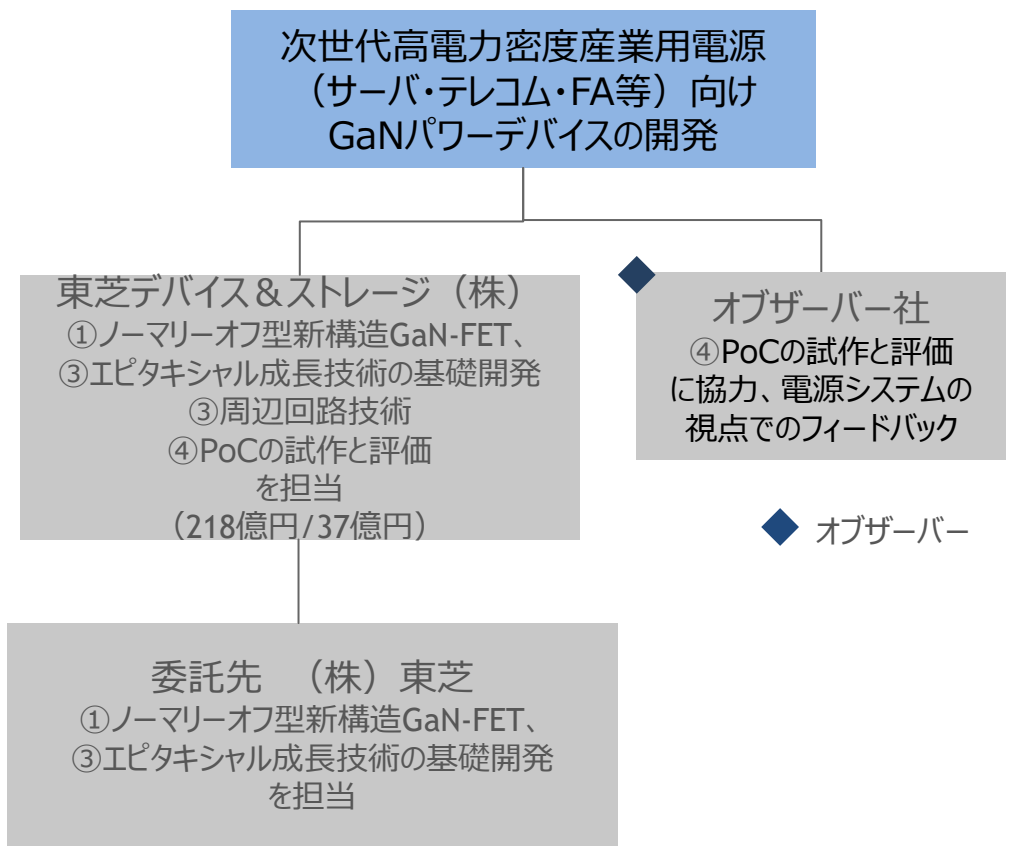
複数の研究開発を効率的に連携させるためのスケジュールを計画



2. 研究開発計画／（４）研究開発体制

各主体の特長を生かせる研究開発実施体制と役割分担を構築

実施体制図 ※金額は、総事業費/国費負担額



各主体の役割と連携方法

各主体の役割

- プロジェクト全体の取りまとめは、東芝デバイス＆ストレージ（株）が行う

研究開発における連携方法（オブザーバーとの連携）

- 東芝デバイス＆ストレージ（株）とオブザーバー社は定期的に連絡会を開催し、会社間の連絡を密に行う。
- 東芝デバイス＆ストレージ（株）はオブザーバー社に対して、研究サンプルや評価ボードの提供を行う

デバイス要素技術開発における委託連携先

- （株）東芝 研究開発センター、及び生産技術センターを委託連携先として、新構造GaN-FET、及び関連するプロセス技術の要素技術開発を担当頂く

スイッチング電源のPoC試作・評価、GaN仕様へのユーザーフィードバック

- オブザーバー社は、GaN応用電源のPoC試作と評価や、デバイスへの要求仕様のフィードバックを担当する

2. 研究開発計画／（5）技術的優位性

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

研究開発項目	研究開発内容	活用可能な技術等	競合他社に対する優位性・リスク
1. ノーマリオフ型新構造GaN-FETの開発	1 デバイス構造設計	<ul style="list-style-type: none">ノーマリオンデバイスにおけるフィールドプレートを用いたデバイス設計技術MOS型デバイスにおける電流コラプス抑制技術	→ <ul style="list-style-type: none">MOSゲートと組み合わせることで、2 DEGキャリア濃度を向上させながら、高閾値と低オン抵抗を両立し、デバイスの高耐圧化が可能
	2 要素プロセス開発・MOS構造形成	<ul style="list-style-type: none">高品質チャネル膜形成技術MOS構造最適化による閾値電圧制御技術GaN上ゲート絶縁膜の高品質化技術	→ <ul style="list-style-type: none">MOSデバイスにおいて、世界トップレベルの高移動度チャネル形成→ 高閾値と高移動度を両立→ 閾値電圧変動抑制に寄与、量産レベルでゲート信頼性実現が課題
	3 プロセスインテグレーション	<ul style="list-style-type: none">8インチGaN-on-Si白色LEDの事業経験	→ <ul style="list-style-type: none">8インチGaN-on-Siの量産経験、ノウハウの活用により、高い量産性を可能とするインテグレーション開発を短期間で実施することが可能

2. 研究開発計画／（5）技術的優位性

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

研究開発項目	研究開発内容	活用可能な技術等	競合他社に対する優位性・リスク
2.高品質・低コスト エピタキシャル成長技術の基礎開発	1 低欠陥化	<ul style="list-style-type: none">中間層を用いた欠陥制御技術	→ <ul style="list-style-type: none">Si基板上GaN結晶で世界トップレベルの低転位密度実現パワーデバイスでは未検証
	2 大口径化 （8インチ化）	<ul style="list-style-type: none">バッファ層技術GaN結晶中の応力制御技術低欠陥GaN形成技術8インチGaN-on-Si白色LEDの事業経験	→ <ul style="list-style-type: none">他社に比べ高い応力制御性、8インチ基板での反り抑制が可能 → <ul style="list-style-type: none">結晶中に生じる応力を制御でき、応力バランスの適正化、反り抑制が可能 → <ul style="list-style-type: none">低欠陥化と反り抑制の両立が可能 → <ul style="list-style-type: none">8インチGaN-on-Siの量産経験、ノウハウの活用により、量産プロセスを考慮した要素技術の開発が可能
	3 スループット向上	<ul style="list-style-type: none">高品質結晶成長技術8インチGaN-on-Si白色LEDの結晶成長プロセス時間短縮の知見、ノウハウ	→ <ul style="list-style-type: none">積層欠陥を抑制する結晶成長技術を基に高速成膜技術を開発し、高品質かつ高スループットを実現可能 → <ul style="list-style-type: none">量産経験・ノウハウの活用により、高品質かつ高スループット化が可能

2. 研究開発計画／（5）技術的優位性

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

研究開発項目	研究開発内容	活用可能な技術等	競合他社に対する優位性・リスク
3. 周辺回路技術	1 電流センサー回路	<ul style="list-style-type: none">10MHz超帯域の絶縁電流センサー回路技術高精度検出のためのばらつき補正技術	<div>→</div> <ul style="list-style-type: none">競合の絶縁電流センサーに対し帯域10倍以上優位 <div>→</div> <ul style="list-style-type: none">バラツキ補正技術によりGaNとの統合パッケージで競合ソリューションより周辺部品削減による高密度化が可能。
	2 ドライブ回路	<ul style="list-style-type: none">伝播遅延時間を低減する高駆動力ゲートドライバ技術	<div>→</div> <ul style="list-style-type: none">広帯域電流センサー回路と低伝播遅延ドライブ回路の組み合わせにより、競合を上回る制御及び保護性能の実現。

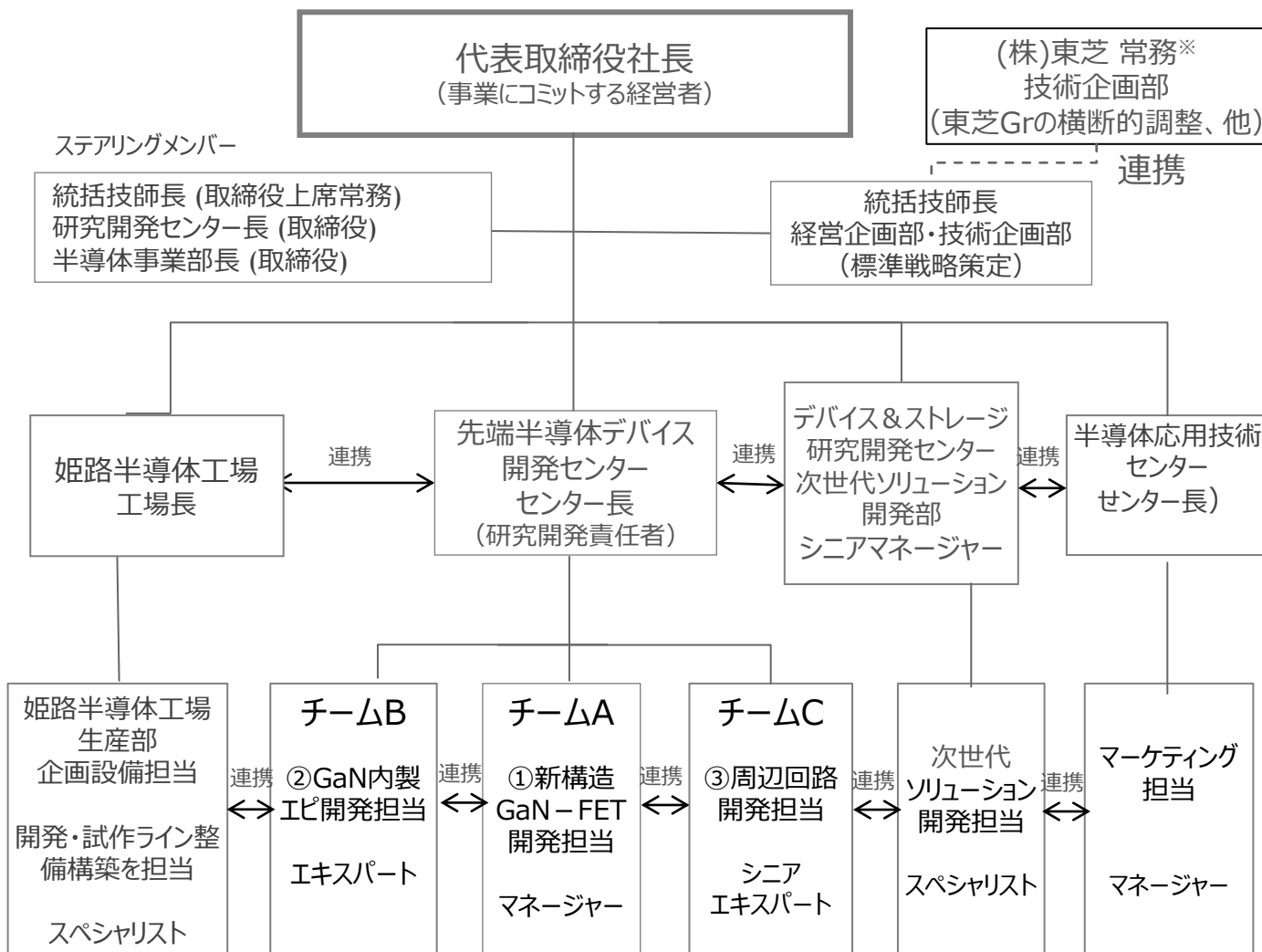
3. イノベーション推進体制

(経営のコミットメントを示すマネジメントシート)

（１）組織内の事業推進体制

経営者のコミットメントの下、専門部署に複数チームを設置

組織内体制図



組織内の役割分担

研究開発責任者と担当部署

- 研究開発責任者
 - 先端半導体デバイス開発センター長：
次世代先端パワーデバイスの開発を統括
- 担当チーム
 - チームA：①新構造GaN-FETの開発を担当
 - チームB：②GaN内製エピ開発担当
 - チームC：③周辺回路開発担当
 - 姫路半導体工場長：開発・試作ライン整備
 - デバイス&ストレージ研究開発センター次世代ソリューション開発部
シニアマネジャー：ソリューション開発・オブザーバー社窓口
 - 半導体応用技術センター長：マーケティング
- チームリーダー
 - チームA：GaN-HEMT開発の実績
 - チームB：GaNエピ開発等の実績
 - チームC：技術開発マネージャの実績

部門間の連携方法

- PJ全体会議（1回/月、開発進捗管理、チーム間情報連携）
- PJステアリングフォロー会議（1回/月、社長報告、フォロー会）
- PJ専用のデータベースを設置し、関連情報を一元管理

標準化体制

- 顧客レイアの標準化動向・連携：マーケティング及ソリューションが担当
- JEDEC・JEITA等技術動向：開発担当 3 チームが担当

※ CSO:Chief standardization officer-最高標準化責任者

3. イノベーション推進体制／（2）マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与

経営者等による当該プロジェクト事業への関与方針

（1）経営者等による具体的な施策・活動方針

- 経営者のリーダーシップ
 - 社長コミットメント
 - 東芝デバイス＆ストレージ株式会社グループは、東芝グループの経営理念である「人と、地球の、明日のために。」に基づき、豊かな価値の創造と地球との共生を図ります。また、脱炭素社会、循環型社会、自然共生社会を目指した環境経営により、持続可能な社会の実現に貢献し、新しい未来を始動させます。

<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/about/environment/statement-of-environmental-philosophy.html>

- 半導体事業部門トップメッセージ
- 半導体はシリコンを材料とするものがほとんどだが、高い電圧や高速な動作など一部の用途では、シリコンで実現できる性能に物理的な限界が訪れようとしている。そこで次世代のパワー半導体として注目されているのが、炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）などの化合物半導体である。シリコンのパワー半導体に比べて、飛躍的な性能の改善が期待されている。具体的には、電力効率が改善することで機器の消費電力を大幅に削減したり、システムの小型化にも寄与したりすることができる。

<https://www.toshiba-clip.com/detail/p=4809>

- 事業のモニタリング・管理
 - 進捗状況のフォロー
研究開発および事業の進捗状況は、取締役社長および担当取締役が出席する月次マネジメント会議の場で定期的にフォローされ、必要により、計画見直し等の意思決定、進め方・内容に対しての指示を行う。
 - 株式会社東芝との連携
事業の進捗を判断するにあたり、親会社の株式会社東芝からの意見も取り入れる。
 - 事業化の判断
目標コストへの到達度合により、事業化の判断を行う。

（2）経営者等の評価・報酬への反映

- 業績評価
事業の進捗状況や成果が、事業部の担当取締役・担当管理職等の評価や報酬の一部（賞与）に反映される。

（3）事業の継続性確保の取組

- 事業の引き継ぎ
経営層が交代する場合は、担当管理職等から事業内容について着実に説明を行うことで、事業が継続し、意思決定に支障をきたすことのないように進める。

2023/03末時点の施策実績（2022/07～2023/03）

- 2021/11～ 進捗状況確認のためのモニタリング会議を毎月開催（計9回）
- 2022/10 2022年度下期 東芝デバイス＆ストレージグループ期初方針説明会にて社長からカーボンニュートラルについて言及
- 2023/01 東芝グループの技術論文誌「東芝レビュー 78巻1号」で経営者が「システムや機器の省エネに寄与する東芝の小型・高効率デバイス技術」を寄稿

3. イノベーション推進体制／（3）マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ

当該プロジェクト事業を経営戦略の中核の一つに位置づけ、広く情報発信

（１）中期計画検討会／経営会議等での議論

- カーボンニュートラルに向けた全社戦略
 - カーボンニュートラルに向けた具体的な取り組みや関連製品ポートフォリオを中期計画検討会等で審議した上で経営会議／取締役会で承認
- 事業戦略・事業計画の審議
 - 研究開発中の技術の事業へ位置づけを確認し、事業戦略・事業計画を策定。中期計画検討会等で事業性の確認と事業化を審議した上で経営会議／取締役会で承認
- 研究開発計画の決議
 - 本プロジェクトに代表されるような国家プロジェクトで、自社の事業戦略または事業計画に対し、重大な影響を及ぼす研究開発計画は、社長が出席するステアリング会議で審議される。また、株式会社東芝の技術スタッフ部門主催による審査会も行われ、技術担当役員により、研究開発計画が審査される。
 - 決議内容の周知
研究開発計画のレビュー会、審査会の決議内容については、議事録が発行され、関係部門に周知される。
- 決議事項と事業戦略・事業計画の関係
 - 事業戦略・事業計画への反映
 - 決議された研究開発計画に基づき、事業戦略・事業計画が策定される。

（２）ステークホルダーに対する公表・説明

- 技術戦略説明会の開催
投資家や金融機関等のステークホルダーに対し、1年毎に技術戦略説明会を開催することで、当社の化合物半導体事業の将来の見通し・リスクを説明する。
- 自社ウェブサイトでの情報発信（プレスリリースによる情報開示）
化合物半導体事業における自社の取り組み（社会的価値等）について、自社ウェブサイトを活用し、ステークホルダーや顧客を含む一般の方々に対し、幅広く分かりやすい情報発信を行う。合わせて展示会等にてPRしていく
- 研究成果等の学会発表
本研究開発で得られた成果を国内外の各種学会で発表、公表する

2023/03末時点の施策実績（2022/07～2023/03）

学会1件（ただし、GI基金対象外）

2022/10/13 国際会議 International Workshop on NITRIDE SEMICONDUCTORS
にて "Fabrication of low on-resistance and normally-off AlGaIn/GaN
MOS-FETs with AlGaIn back barrier by selective area re-growth
technique" を発表

3. イノベーション推進体制／（４）マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保

機動的に経営資源を投入し、着実に社会実装まで繋げられる組織体制を整備

（１）経営資源の投入方針

- 実施体制の柔軟性の確保
 - 開発体制や手法の見直し、追加的なリソース投入の準備・体制
ステアリングメンバーがプロジェクトのマネジメント状況のモニターを行い、必要に応じ、開発体制や手法の見直しを行う。また、プロジェクトマネジメントメンバーは研究開発リソースに関わる権限を委譲され、進捗状況に応じ、追加的なリソース投入を行う。
 - 外部リソースの活用
プロジェクトマネジメントメンバーは外部リソースに関わる権限も与えられ、必要に応じ、外部リソースの活用を行う。
→実績：計９回のステアリングフォロー会にてモニタリングを実施。
- 人材・設備・資金の投入方針
 - 人材の確保
本プロジェクトを推進するため、当社で当該技術領域を専門に担当している人員の確保を優先的に実施する。
 - 既存設備の活用
当社で保有する既存の設備を最大限に活用する。また、委託先でも同様に、既存の設備の活用を行う。
 - 国費負担以外での資金投入
社内の研究開発費を充当する。
 - 資金投入の継続性
本プロジェクトの計画と予算は、中期計画策定に織り込み、さらに応募前に社長決裁を取得し、資金投入の継続性について社内的合意を形成している。なお、本プロジェクトの応募については、株式会社東芝からも承認を得ており、本プロジェクトの運営がサポートされる。

（２）組織横断体制の構築

- 組織横断体制の構築
 - 機動的な意思決定
当該事業を遂行するため、組織横断で人員を集結しプロジェクト体制を構築。本プロジェクトの運営に関する権限はプロジェクト体制内で全て完結しており、機動的な意思決定を可能とする。
 - 事業環境の変化への対応
組織横断のプロジェクト体制により、既存の組織体制や事業体制にとらわれず、柔軟にビジネスモデルの検証を行い、事業環境の変化への対応を可能とする。
- スタッフ部門のサポート
 - 社内規程、システムの整備
本プロジェクトの運営のサポートのため、必要により、スタッフ部門が社内規程、システムの追加、見直しを行う。
 - 進捗レポートの提出
本プロジェクトの進捗について、スタッフ部門に定期的にレポートを提出することで、状況が随時フォローされる。
- 若手人材の育成
 - 若手チームメンバーの起用
今後の中長期的な化合物半導体事業の発展に寄与するため、若手人材を積極的にチームメンバーに起用し、プロジェクト活動の中で技術的育成を図る。
 - 技術報告や論文提出の機会の活用
若手チームメンバーが、本プロジェクトの技術成果について、技術報告書や論文等の形で社内外に発信することを支援し、技術者としての能力向上を図る。

4. その他

4. その他／（１）想定されるリスク要因と対処方針

想定されるリスクと対応および事業中止の判断基準

研究開発（技術）におけるリスクと対応

- 装置開発遅れによるデバイス開発の遅延
→ 装置ベンダとの協調、連携強化
- SiやGa2O3の想定外の技術革新により、GaNの競争力が相対的に低下
→ 技術動向を調査し、適宜目標や検討アイテムの見直しを行う
- 目標とする機能・性能が確保できないリスク
→ 期毎にKPIを設定し技術開発進捗を管理し、目標達成の確度を向上、フォローアップしていく

社会実装（経済社会）におけるリスクと対応

- 高周波スイッチング回路の周辺部品価格高騰によるGaN電源市場伸長の停滞
→ 部品メーカーとの連携模索
- 投資回収計画の破綻
→ 市場停滞
→ スwitching電源以外の市場への展開
→ 競合他社に対しての遅れによる参入機会損失
→ ベンチマークにより立ち位置の確認を実施すると共に、必要に応じたリソース増強、他社連携

その他（自然災害等）のリスクと対応

- Ga原材料の高騰（地政学的に）
→ 調達先との連携
- データセンターレイヤのパラダイムシフトによる産業構造の大変化
→ 他市場への展開
- 大地震などの自然災害により研究継続不可
→ 関東地区と近畿地区の2拠点での開発などの工夫



- 事業中止の判断基準：
 - 災害や、グローバル経済の悪化などの事業環境変化により、計画通り自己資金投下が不可能になった場合
 - 当初計画より投資回収に著しい遅れが生じた場合